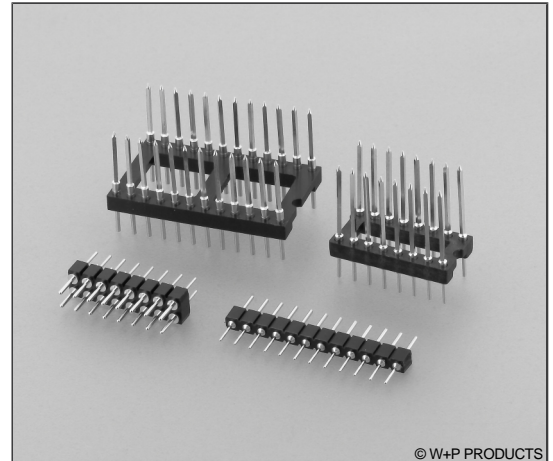
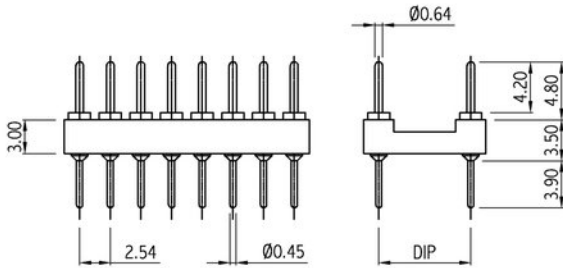


### Technische Daten / Technical Data

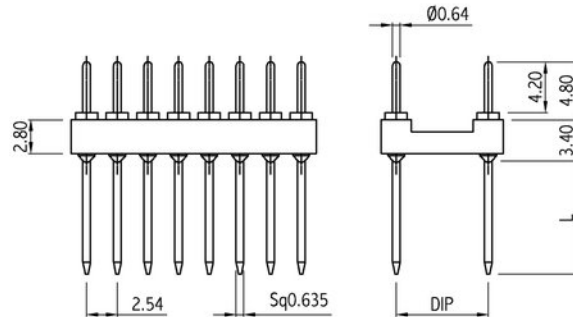
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ < 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ > 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>RMS</sub> 1kV <sub>RMS</sub>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub> 100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A 1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C -55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



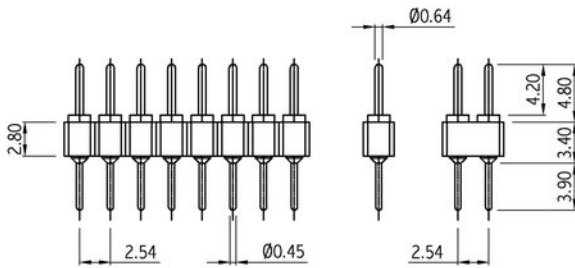
© W+P PRODUCTS



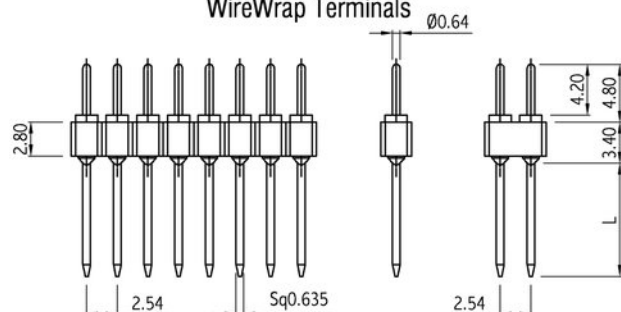
IC DIP Sockets 178



WireWrap Terminals



IC Headers 191



<b>Series</b> <b>178</b>	<b>Contacts*</b> <b>24</b>	<b>DIP-Spacing*</b> <b>4</b>	<b>Terminals*</b> <b>10</b>	<b>Plating*</b> <b>00</b>
178 IC-Fassungen IC Sockets	06-24 28 =====> 20-24 28 32 =====> 10 24 28 32 36 40 42 48 50 52 =====> 50 52 64 =====>	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 L=3,90 Ø0,45mm 20 L=9,40 Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95 Sq0,635mm WireWrap	00 10 30 50 (siehe unten) (please see below)

<b>Series</b> <b>191</b>	<b>Contacts*</b> <b>16</b>	<b>Rows*</b> <b>2</b>	<b>Terminals*</b> <b>10</b>	<b>Plating*</b> <b>00</b>
191 IC-Leisten IC Headers	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 L=3,90 Ø0,45mm 20 L=9,40 Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95 Sq0,635mm WireWrap	00 Vergoldet Gold plated 10 Vergoldet 0,25µm (Option) 10µ" gold plated (Option) 30 Vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated 50 Verzinkt Tin plated

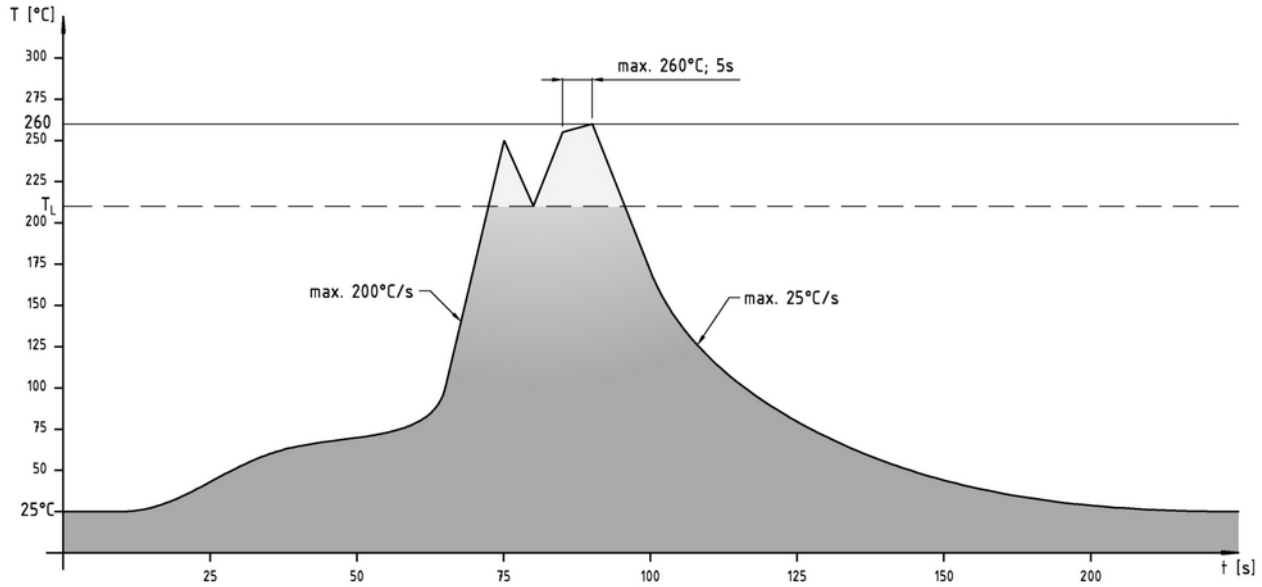
\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



### Reflow-Lötempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

